

杰华特微电子股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告

为深入贯彻落实中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，践行以投资者为本的上市公司发展理念，推动杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）持续优化经营、规范治理并积极回报投资者，公司已制定 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》。公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作。2026 年上半年，公司实现营业收入 171,837.31 万元，同比增长 44.72%；公司营业收入季度环比实现增长，其中公司第二季度实现营业收入 95,362.14 万元，同比增长 44.66%，环比增长 19.81%；归属于上市公司股东的净利润为-51,997.04 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-57,616.49 万元，上半年度亏损额同比较上年同期有所增加，公司归属于上市公司股东的净利润第二季度较第一季度实现环比减亏。2026 年上半年，公司研发投入 63,299.35 万元，研发投入占营业收入的比例为 36.84%，同比增加 1.39 个百分点。现将主要执行进展情况评估如下：

一、聚焦经营主业，提升核心竞争力

报告期内，公司坚持研发创新与一站式全产品线的布局策略，持续加大研发投入、丰富产品线布局及内部业务资源的配置。公司持续深化实施“技术引领+生态布局”双轮驱动战略，从产品研发、市场布局、供应链管理、客户拓展、内部治理以及业务投资拓展等各方面均取得较大突破和进展。2026 年上半年，公司通过精准的市场定位和持续创新，成功推出多款有竞争力的产品，进一步巩固了在计算与存储、汽车电子、新能源、网通安防等关键应用领域的市场地位，提升了核心竞争力和市场份额。报告期末，公司及控股子公司在模拟芯片领域拥有丰富的产品组合，在售产品型号超 4,200 款，展示了强大的产品谱系和技术储备。

（一）打造自主工艺平台，持续迭代核心技术

公司自创立伊始，始终坚持发展独立自主的芯片研发技术，已构建起集工艺、设计以及系统于一体的完整研发技术架构。公司突破行业固有工艺水平的桎梏，充分利用国内晶圆厂现有资源，组建专业工艺团队，针对产品需求开发定制工艺，确保工艺制造水平与芯片开发需求相匹配，实现芯片最优性价比。目前，公司已在国内主要晶圆厂建立了 55 纳米的 5 至 55V 中低压 BCD 工艺、0.18 微米的 10 至 200V 高压 BCD 工艺以及 0.35 微米的 10 至 700V 超高压 BCD 工艺等三大类工艺平台，形成了较完备的自研工艺体系。2026 年上半年，公司在现有工艺的基础上持续迭代，55nm BCD 工艺平台已开发完成，相关产品正基于此平台开发中，尚未实现量产。各工艺平台的迭代研发，通过加强更低功耗、更高集成度、更高功率密度的优化，将为更多差异化产品的研发奠定更加坚实的基础。

（二）深挖创新应用，推动全品类产品布局

公司长期专注于集成电路设计与研发，已构建起从技术预研、产品设计、工程实现到应用开发的多层次研发体系。经过十余年沉淀，公司已形成覆盖广泛的多元产品矩阵，包括 AC-DC、DC-DC、线性电源和电池管理等四大类电源管理产品线，以及检测产品、接口产品、转换器产品、时钟产品、线性产品、传感器产品、高速信号产品等信号链产品线，涵盖模拟芯片的主要类别，实现了多品类、多层次的发展格局。报告期内，公司产品在计算与存储、汽车电子、新能源、网通安防等多个关键应用领域实现技术落地与市场认可。

计算与存储领域，公司推出多款高性能多相控制器及 DrMOS 大电流产品，包括支持多协议的 16 相数字控制器等，已送样多个计算行业头部客户。同时，公司推出了基于新一代工艺的大电流 DC-DC 迭代产品，各方面性能大幅度提升；推出的带数字接口和黑盒子智能化功能的新一代 18V/60A 电子保险丝，具备智能化、导通功耗小、恶劣情况下保护性能强等优势。

汽车电子领域，公司在智能驾驶、智能座舱、车身等方面全面推进。具体包括：推出了多款面向智能驾驶和智能座舱等领域的 ASIL-D PMIC 产品；推出了车规 90A DrMOS 和车规 4 相控制器，并进入多个客户；车规高边驱动和 eFuse 产品推进系列化布局，并陆续推出适用于车身控制的多通道电机驱动产品；面向下一代 48V 的系列产品陆续进入送样阶段。

新能源领域，公司推出了新一代主动均衡芯片，并实现了大批量发货；同时推出了多款高串数 BMS AFE 芯片（27 串、16 串等），已经送样多个行业头部客户。

网通和安防领域，公司推出了多款 PoE 以太网供电芯片，包括新一代内置 MCU 的 8 路 PSE 供电芯片、多款集成协议与功率的隔离型 IEEE 802.3af PD 受电端芯片、多款集成协议与功率的非隔离型 IEEE 802.3af PD 受电端芯片，多款产品已开始供货，获得客户高度认可。

在信号链领域，公司持续推进检测、接口、转换器、时钟、线性、传感器、高速信号、驱动等关键产品线的开发。报告期内，公司推出了多款多通道模数/数模转换芯片、精密电流检测芯片、高精密时钟芯片、运放和比较器等系列芯片。公司通过自主研发与并购整合双轮驱动，逐步构建起品类丰富的传感器产品矩阵，并不断拓展应用覆盖边界。

（三）优化供应链协同，驱动效率与响应双提升

供应链作为核心竞争力的关键载体，其韧性直接影响公司的市场响应速度与交付保障能力。2026 年上半年，面对复杂多变的外部环境，公司坚持“效率驱动、价值共创”理念，通过数字化赋能与机制创新，着力构建敏捷高效的供应链体系。

在外部协同方面，公司与晶圆制造、封装测试等上游核心供应商持续深化战略合作伙伴关系，保障供应安全稳定的同时，通过技术协同创新推动运营效率与产品竞争力的双重提升。在内部联动方面，公司建立了供应链与研发、生产、销售部门的季度战略对齐机制，实现供应链规划与公司整体战略的动态匹配，构建起从前端需求洞察到后端交付执行的高效闭环，为公司保持市场竞争中的快速响应能力提供了坚实支撑。

（四）深耕客户版图，多维提升市场渗透率

报告期内，公司针对经营目标深入市场调研，为产品的定义和开发提供依据；根据产品特性、目标市场和资源状况选择相应的拓展渠道；通过 CRM 系统记录客户信息、互动历史和交易记录，分析客户行为和需求；通过定期沟通、满意度调查等方式保持与客户的良好互动，提升客户忠诚度；同时通过参加多个线下展会及论坛活动，作为展示公司技术实力和产品优势的重要平台，如受邀参与 2026 北京国

际汽车展览会的《吉利汽车 SerDes 技术白皮书》发布仪式、2026 杭州国际半导体与集成电路产业创新展览会及第四届中国国际供应链促进博览会等重要行业活动，及时把握前沿技术发展趋势，为公司洞察行业演进方向、布局未来技术赛道拓宽了视野。

（五）持续推进降本增效，精益运营管理

公司在营运管理中秉承精细化理念，采用关键指标管理模式，在质量管理、成本管控、客户技术支持等关键环节设定了一系列严格的考核指标，全面覆盖质量、效率、成本、安全等多个维度。公司定期对各项指标的执行情况进行跟踪和评估，并根据统计数据和客户反馈意见开展内部讨论，制定改进措施，不断优化关键指标体系；同时致力于不断完善和升级信息系统，通过引入先进的信息技术和管理工具提高数据处理的自动化水平，加强跨部门间的协同作业，从而显著提升整体运营效率。通过一系列综合性的管理和改进措施，公司能够确保在快速变化的市场环境中保持竞争力，同时为客户提供更高质量的产品和服务。公司持续的管理和技术创新是推动企业长期发展和成功的关键。

（六）统筹内外发展，并购整合赋能

2026 年上半年，公司持续推进前期并购项目的深度整合，聚焦存量并购标的（如天易合芯、领芯微）与集团现有业务的全面融合，统筹盘活技术、人才、渠道等关键产业资源，推动内部资源配置持续优化，通过业务互补优势，公司着力打通各板块间的联动通道，挖掘增量空间，稳步构建高效协同的产业生态体系，为战略目标的落地提供了坚实支撑。

（七）冲刺国际资本市场，推进海外布局

为加快公司的国际化战略及海外业务布局，增强公司的境外融资能力，进一步提高公司的资本实力和综合竞争力，报告期内，公司持续推进境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作。

（八）加强募投项目管理，优化资本配置效能

报告期内，公司持续加强募集资金管理，结合募投项目实施进展，报告期末，公司的募投项目均已结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生

产经营。报告期末，公司的部分募集资金专户正在办理注销中。公司的募集资金相关事项均已履行必要的审议程序，保荐机构出具了明确同意的核查意见，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，有助于提高募集资金使用效率、合理分配资源、提升公司经营效益。

二、提升科技创新能力，加快研发成果转化

报告期内，公司始终将客户需求作为研发创新的核心导向，构建了市场洞察、快速响应、持续迭代的研发闭环机制。公司持续强化研发资源配置，深度聚焦行业前沿技术领域，加速产品迭代升级步伐，在巩固现有技术壁垒的同时，围绕产业发展趋势进行前瞻性战略部署。公司秉持研发创新驱动与一站式全产品线协同发展策略，既着眼于短期市场波动的有效应对，更致力于构建可持续的核心竞争优势，以此巩固行业领先地位，为股东及客户创造长期稳定的价值增长。

截至报告期末，公司及控股子公司研发人员共 1,251 人，占总人数的 59.32%，研发人员的数量同比增长 22.41%；报告期内，公司及控股子公司新增专利申请 147 项，其中发明专利申请 127 项，实用新型专利申请 20 项；累计核心技术已申请国内外专利 1,838 项，其中发明专利 1,381 项；已获得有效国内外专利 865 项，其中发明专利 615 项；已获得集成电路布局设计登记证书 169 项。

2026 年上半年，公司荣获世界电源网颁发的智算供电方案行业优秀奖，证明公司智算供电解决方案的技术实力、方案成熟度获得行业权威认可；荣获中国汽车芯片联盟“2026 年度创新力汽车芯片”奖，体现了公司在汽车芯片领域持续的创新能力和产品市场价值。2026 年 7 月，公司参与完成的“高精度低功耗模拟前端集成电路关键技术与应用”项目荣获国家科学技术进步奖二等奖，充分彰显了该项目技术先进性与行业价值。公司持续保持高水平研发投入，构建起技术创新与产品迭代的核心驱动体系，形成具有战略性、前瞻性的技术护城河，为公司实现可持续发展奠定坚实基础。

三、完善公司治理架构，提升治理效能

公司始终将完善治理体系作为驱动高质量发展的核心引擎，通过持续优化公司治理，保障公司规范、健康、可持续发展。

（一）完善制度体系，深化内部治理

2026年上半年，公司对照《上市公司治理准则》等最新监管规定，同步修订完善多项内部管理制度。报告期内，公司内审部门严格执行定期审查机制，围绕财务及运营活动开展全流程合规性审计，确保各项业务流程严格遵循法律法规与企业管理制度。同时，公司持续深化企业治理结构改革，通过完善决策机制、强化监督体系，切实保障决策过程的公正性与科学性；积极推进管理革新，通过精简决策层级、优化执行链条、构建全员责任体系等举措，全面提升管理效能与响应速度。上述综合治理举措的系统推进，为公司实现可持续价值增长筑牢根基。

（二）健全财务内控，构筑严密风险意识

财务内控制度的健全是模拟芯片公司稳健运营的重要保障，能够有效地构筑起企业严密的风险意识。公司已建立一套全面、高效的财务内控制度，该制度涵盖了从资金管理、费用审批、收入确认到财务报告的全过程，确保了公司财务活动的合规性、安全性和有效性。通过精确的成本控制和资金流向监控，公司能够确保资金的合理配置和有效使用，从而在激烈的市场竞争中保持优势；通过定期的内部审计和风险评估，公司能够及时发现并应对潜在的财务风险和内部不当行为，从而保障公司资产的安全和企业运营的稳健。此外，该制度还强调了员工的财务责任意识和道德规范，通过持续的培训和教育，提升了全体员工对于财务管理重要性的认识，形成了全员参与的内控文化，为企业的可持续发展提供了坚实的保障。

（三）优化董事会构成，提升规范运作水平

2026年4月，公司董事会收到公司非独立董事方伟先生提交的书面辞职报告，方伟先生因个人原因申请辞去公司非独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，公司于2026年4月29日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名姚海锋先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，上述议案已经2026年5月15日召开的2025年年度股东会审议通过，进一步完善了董事会组成。

四、夯实质量管理体系建设，筑牢品牌信誉

公司高度重视质量管理体系建设，构建了健全的质量管理体系，并制订了严格的质量技术规范与控制流程，通过精准的产品设计、周密的供应链管理、先进的检测流程以及及时有效的售后服务，确保了产品的高质量和卓越性能，实现了从设计到生产、测试再至运营管理的全流程质量管控。目前公司已获得 IATF 16949 汽车行业质量管理体系认证、ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系认证、ISO26262 ASIL-D 功能安全认证及 IECQ QC080000 有害物质过程管理体系等认证。得益于优质质量保障体系，公司产品在各类应用环境中均展现出了高度的稳定性，其上线失效率大幅度低于客户所规定的标准，产品的高性能和优质保障成为了公司拓展客户群体、建立品牌信誉的坚实基础。依托领先的技术实力和优质的产品质量，在业内主要市场和应用领域，公司产品占有率逐年攀升，市场地位稳步提升。

五、压实关键少数责任，完善激励约束机制

（一）激活薪酬契约刚性

2026 年上半年，公司持续推进薪酬与经营业绩挂钩机制建设，不断优化业绩考核指标体系。同时，根据最新的《上市公司治理准则》对公司的相关制度开展修订工作，推动管理层薪酬与公司经营效率等实现合理联动。同步推进绩效薪酬追索等机制搭建，逐步实现激励与约束并重、权利与责任对等，为公司持续稳健发展夯实制度基础。

（二）驱动人才梯队升级

公司将人才梯队建设作为战略性、系统性工作持续推进，人才发展体系优化工作稳步开展。2026 年上半年，持续深化人才工作机制建设，在精准识别人才需求、分层分类人才培养、健全选拔任用及激励机制等方面有序推进相关工作，聚力打造结构合理、素质优良、充满活力的人才队伍，为公司高质量发展强化人才保障与智力支撑。

六、强化管理层与股东利益共担共享约束，完善激励约束机制

公司持续完善与经营状况挂钩的激励机制，将管理层利益与公司经营成果深度

绑定，强化管理层与股东的利益共担共享约束。

（一）强化股权激励与约束

公司持续强化股权激励约束，将员工个人利益与公司长远发展紧密捆绑。在集成电路行业中，优秀人才对于公司的技术创新、产品研发和市场竞争至关重要。随着公司业务的快速发展和市场的不断扩张，对高素质人才的需求也日益增加。为吸引和留住关键人才，公司于 2024 年度实施了 2024 年限制性股票激励计划，并于 2025 年度完成了 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属登记工作，进一步提高了团队的凝聚力。相关股权激励事项已在临时公告披露，后续公司将根据股权激励实施进展及时履行信息披露义务。

（二）健全人才团队与激励约束机制

公司已建立了一支从技术研发、生产管理、质量管控、市场营销以及财务管理等各方面配置完备、协同互补、架构稳定的管理团队，管理人员拥有丰富的从业经验，具备专业的技术和管理能力。公司主要核心员工均拥有国内外知名大学的深厚教育背景，并曾长期服务于国际领先的模拟集成电路厂商一线岗位，在专业技能、产品研发、市场开拓等各个环节积累了扎实的基础和丰富的经验。依托于公司管理团队的能力和 experience，公司能够有效地判断行业发展趋势，专业地解读产业政策，从而把握市场机会，实现长期可持续发展。

七、畅通沟通渠道，提升投资者关系管理质效

2026 年上半年，公司持续完善投资者沟通机制。通过业绩说明会、一图读懂等可视化方式解读定期报告，有效提升信息披露可读性。通过电话、邮件等方式将投资者意见及时收集反馈。公司董事长、总经理等主要负责人积极参与投资者交流活动，进一步增进资本市场对公司发展战略及经营成果的认知理解。同时，公司强化舆情风险防控，落实实时舆情监测，密切跟踪市场动态，切实维护公司市场声誉与广大投资者合法权益。

八、环境与社会责任

公司积极推进 ESG 报告编制工作，较为系统地展示了公司可持续发展综合实力。公司及控股子公司主要从事芯片设计研发工作及芯片测试的相关业务，不直接

进行产品生产制造工作，研发过程中不会产生工业废水、废气、废渣与噪声等，不会对环境产生污染；公司及控股子公司主营业务不属于国家规定的重污染行业，不涉及环境污染情形，不涉及相关的环境污染物及处理设施。公司将按要求持续做好环境保护、社会责任及公司治理相关工作，积极践行可持续发展理念。

九、其他事宜

2026年下半年，公司将持续深入落实“提质增效重回报”专项行动，锚定核心主业，不断激发内在潜力，全面提升核心竞争力，始终坚持以股东利益为核心，特别是高度重视中小股东的合法权益，推动公司发展成果更好惠及广大投资者，携手共促公司实现高质量、可持续发展。公司将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及上海证券交易所相关业务规则，及时、准确、完整地履行信息披露义务，持续保障投资者知情权、参与权，积极构建与投资者的良性互动机制。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

杰华特微电子股份有限公司

董事会

2026年8月25日